

2102060-2 ✓ 有效

Mezalog | Mezalog HSLF

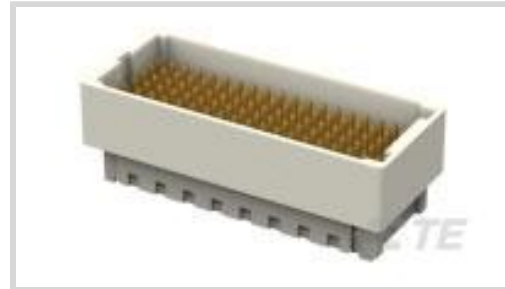
TE 内部编号 2102060-2

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Mezalog HSLF

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector



连接器系统: 板对板

位数: 114

行数: 6

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector \(34\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 全部带罩     |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |     |
|----------|-----|
| 板对板配置    | 平行  |
| 可堆叠      | 是   |
| 位数       | 114 |
| 行数       | 6   |
| PCB 安装方向 | 垂直  |

### 电气特征

|            |         |
|------------|---------|
| 介质耐压 (最大值) | 750 VAC |
| 工作电压       | 250 VAC |

### 主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

### 接触件特性

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 端子布局          | 矩阵                             |
| 对接公端宽度        | .43 mm[.017 in]                |
| 对接公端厚度        | .46 mm[.017 in]                |
| 端子接合区域电镀材料厚度  | 1.27 $\mu$ m[49.9999 $\mu$ in] |
| 端子形状和构造       | 正方形                            |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 亮光                             |
| 端子底板材料        | 镍                              |
| 端子基材          | 磷青铜                            |
| 端子接触部电镀材料     | 金                              |
| 端子类型          | 插针                             |
| 端子额定电流（最大值）   | 1.5 A                          |

### 端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 - 焊球 |
|----------|-----------|

### 机械附件

|            |      |
|------------|------|
| PCB 安装对准类型 | 无    |
| 接合对准类型     | 极化公端 |
| PCB 安装固定类型 | 焊球   |
| 连接器安装类型    | 板安装  |
| 接合对准       | 带有   |
| PCB 安装对准   | 不带   |
| PCB 安装固定   | 不带   |

### 壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 接合入口位置  | 顶部              |
| 外壳材料    | LCP（液晶聚合物）      |
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |

### 尺寸

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 堆叠高度       | 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm[.393 in] |
| 连接器高度      | 9.15 mm[.36 in]                     |
| PCB 厚度（建议） | 2.36 mm[.093 in]                    |
| 行间距        | 1.27 mm[.05 in]                     |

### 使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用

|        |          |
|--------|----------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖, 拾放盖 |
| 电路应用   | Signal   |

### 行业标准

|      |         |
|------|---------|
| 工业标准 | VITA 61 |
|------|---------|

### 包装特性

|      |            |
|------|------------|
| 封装数量 | 230        |
| 封装方法 | 卷带包装, 卷带包装 |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力  | 回流焊接可达到 260°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Mezalok HSLF



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102060-2\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102060-2\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102060-2\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[SOSA Aligned Interconnect Solutions](#)

英文版本

[Mezalok Connector Brochure](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本